



4979

華星光通科技(股)公司
LUXNET Corporation
法人說明會
2024 Earning Release

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息可能包含對於未來展望的表述，本公司不暗示、不聲明亦不保證其內容之正確性或可靠性，使用者應自行判斷與承擔風險。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。有些資訊可能受未來不確定性因素影響，致使與原先本公司對於未來前景的說明迥異。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

本簡報資料中所提供之資訊不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

簡報 大綱

公司簡介

經營實績

技術及製程能力

市場趨勢及未來展望

Q & A

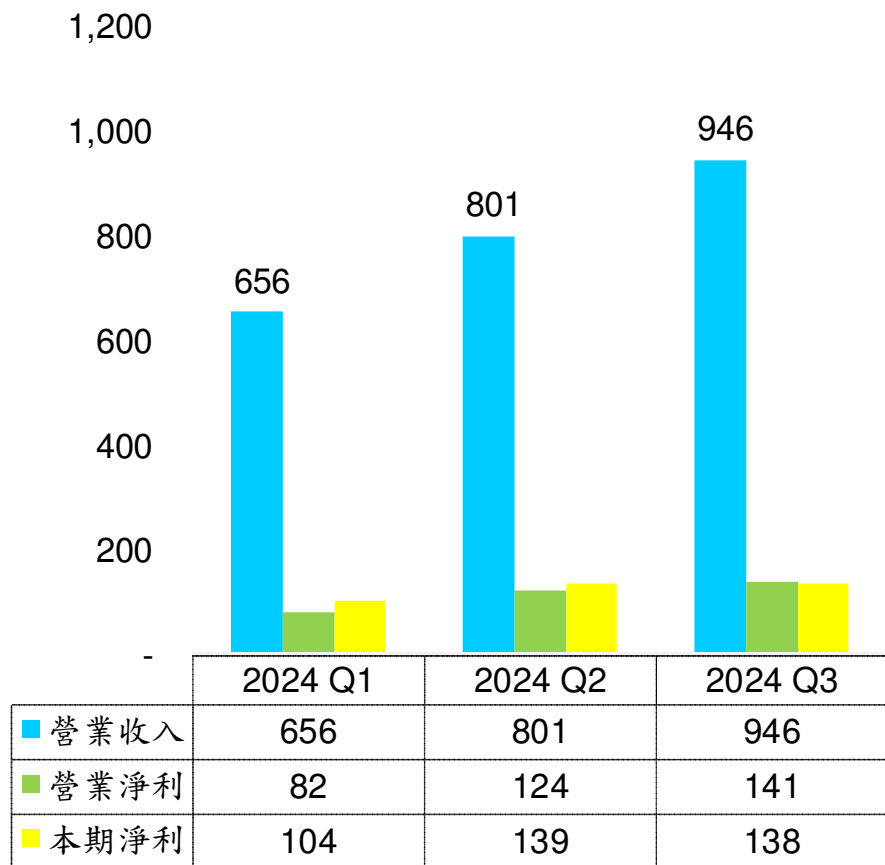
公司簡介

成立日期	2001/11/15
實收資本額	新台幣1,408百萬元
所在地	桃園市中壢區合江路6號
員工人數	502人
主要產品及服務	LD & PD, TO-can, OSA, Optical Engine, ELS, CoC. Transceiver. OEM & ODM / Foundry Business

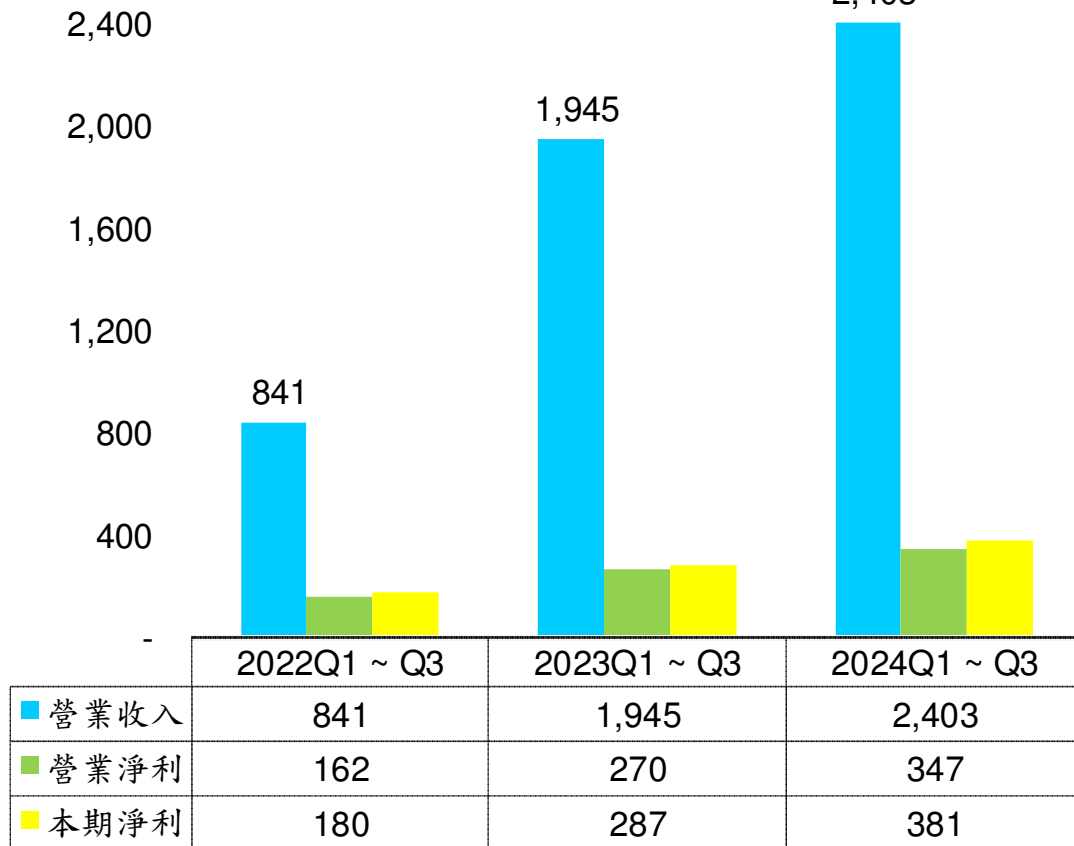


營業收入及淨利-趨勢圖

單位：新台幣百萬元

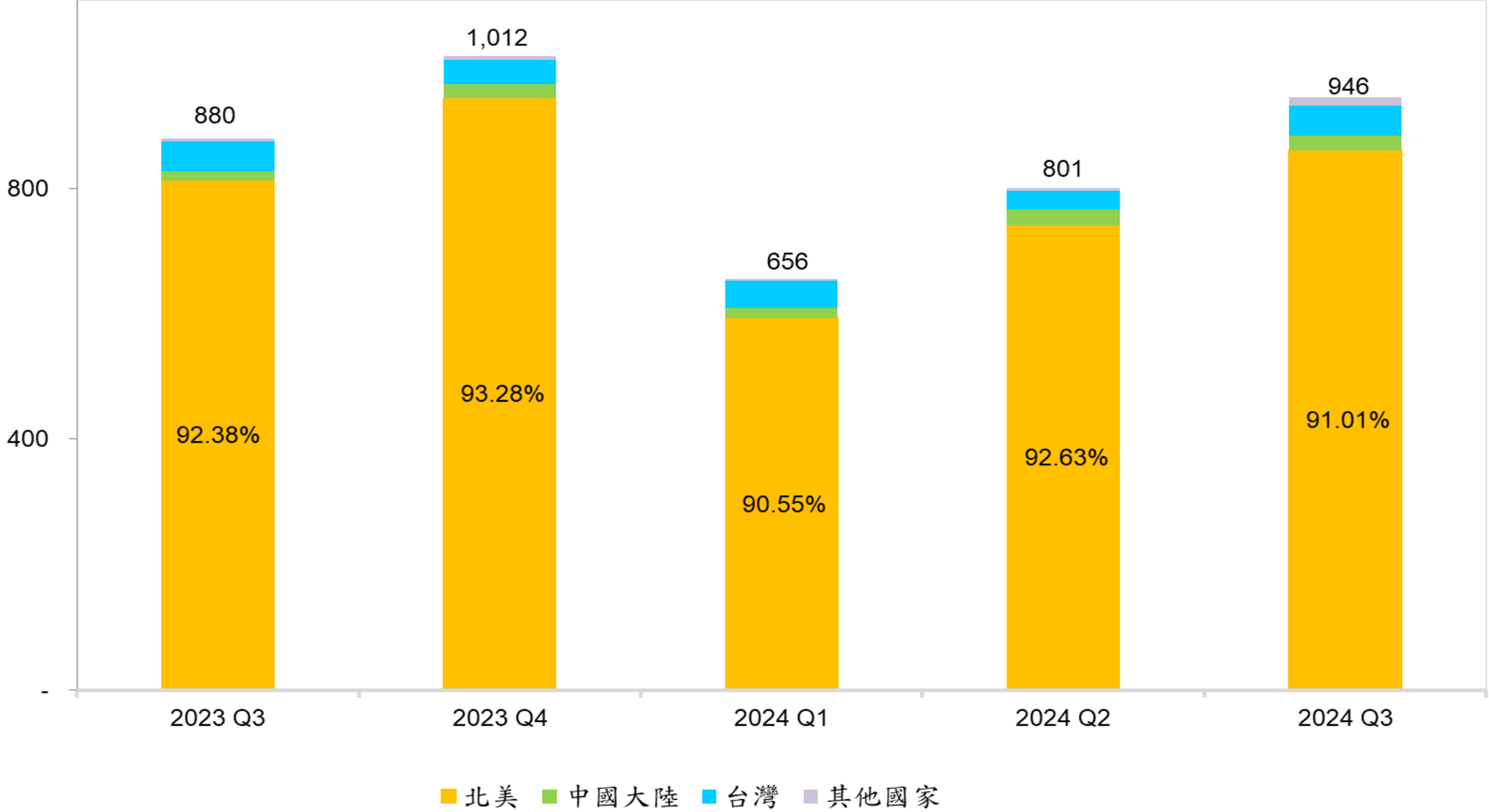


單位：新台幣百萬元



營業收入-地區別

單位：新台幣百萬元



資產負債表

單位：新台幣百萬元	2023/9/30		2023/12/31		2024/9/30	
現金及約當現金	791	34.0%	1,832	52.0%	2,273	59.1%
應收票據及帳款淨額	233	10.0%	300	8.5%	364	9.5%
存貨	417	17.9%	560	15.9%	448	11.6%
其他流動資產	33	1.4%	35	1.0%	47	1.2%
流動資產	1,474	63.4%	2,727	77.5%	3,132	81.4%
不動產、廠房及設備	677	29.1%	654	18.6%	608	15.8%
公允價值衡量之 金融資產(FVOCI)	169	7.3%	132	3.8%	87	2.3%
其他非流動資產	6	0.3%	7	0.2%	22	0.6%
非流動資產	852	36.6%	793	22.5%	717	18.6%
資產總額	2,326	100.0%	3,520	100.0%	3,849	100.0%
流動負債	368	15.8%	484	13.8%	678	17.6%
非流動負債	220	9.5%	-	0.0%	-	0.0%
負債總額	588	25.3%	484	13.8%	678	17.6%
普通股股本	1,323	56.9%	1,408	40.0%	1,408	36.6%
資本公積	4	0.2%	1,099	31.2%	1,099	28.6%
保留盈餘	389	16.7%	543	15.4%	723	18.8%
其他權益	22	0.9%	-14	(0.4%)	-59	(1.5%)
權益總額	1,738	74.7%	3,036	86.3%	3,171	82.4%
負債及權益總額	2,326	100.0%	3,520	100.0%	3,849	100.0%
每股淨值(元)	13.14		21.56		22.52	

損益表

單位：新台幣百萬元	2023	2024		季變化	年變化	2023	2024	年變化
	Q3	Q2	Q3	QoQ	YoY	Q1~Q3	Q1~Q3	YoY
營業收入	880	801	946	18.1%	7.5%	1,945	2,403	23.5%
營業毛利	184	159	173	8.8%	(6.0%)	366	451	23.2%
營業費用	35	35	32	(8.6%)	(8.6%)	96	104	8.3%
營業淨利	149	124	141	13.7%	(5.4%)	270	347	28.5%
營業外收支	16	16	-3	-	-	17	35	105.9%
稅前、息前、折舊攤銷 前獲利	187	153	146	(4.6%)	(21.9%)	355	417	17.5%
所得稅	-	-1	-	(100.0%)	-	-	-1	-
本期淨利	165	139	138	(0.7%)	(16.4%)	287	381	32.8%
基本每股盈餘(元)	1.25	0.99	0.98	(1.0%)	(21.6%)	2.17	2.71	24.9%

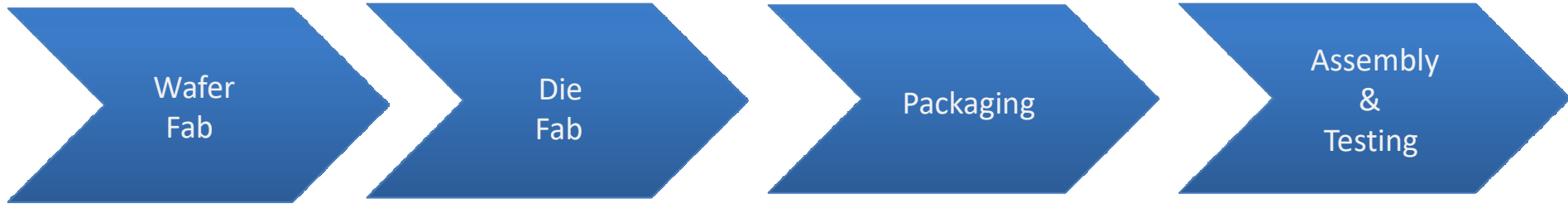
現金流量表

單位：新台幣百萬元	2023Q1~Q3	2024Q1~Q3
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	287	383
折舊及攤銷費用	69	56
其他非現金之收益費損調整	46	-44
本期收付利息及所得稅	0	18
資產/負債變動數	13	45
營業活動之淨現金流入(流出)	415	458
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-47	-15
處分不動產、廠房及設備	0	1
其他投資活動	-1	-3
投資活動之淨現金流入(流出)	-48	-17
融資活動之現金流量		
長短期借款變動	-52	0
發放現金股利	-8	0
融資活動之淨現金流入(流出)	-60	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	307	441
期初現金及約檔現金餘額	484	1,832
期末現金及約檔現金餘額	791	2,273
自由現金流量	367	441

重要財務比率

單位：%；天數	2023/9/30	2023/12/31	2024/9/30
流動比率	400.5%	563.4%	461.9%
負債比率	25.3%	13.8%	17.6%
CCC Days	62	62	59
存貨週轉天數	77	79	71
應收帳款週轉天數	34	34	38
應付帳款週轉天數	49	51	50

技術及製程能力



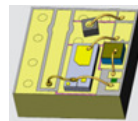
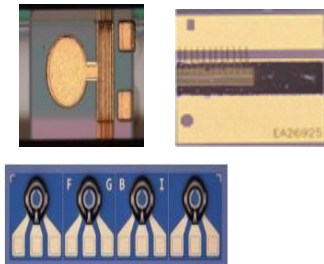
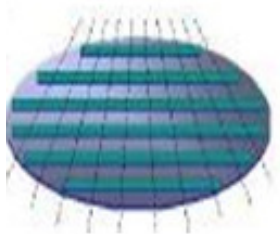
2-4 inches InP_based wafer

- Photolithography(Stepper)
- High quality dielectric thin film deposition(PECVD)
- Dry etching(RIE, ICP)
- Metal deposition and alloy
- Wafer lapping/polishing
- Confocal microscopy/ profile meter/SEM

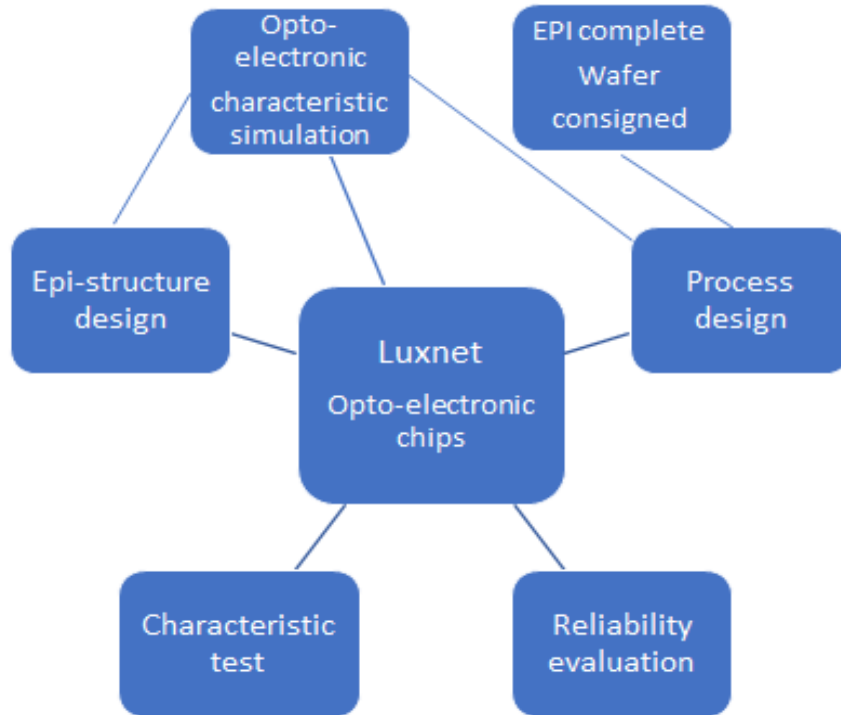
- Cleaving and dicing
- High quality optical facet coating (ECR, IAD-E beam)
- Testing and sorting
- AOI visual inspection

- To-CAN packaging
- Box/Butterfly packaging
- Chip-on-carrier
- Chip-on-PCB
- Feature process
 - laser assisted bonding
 - high-precision placement (<3um)
 - Flip-chip bonding
 - Fiber Array Attachment

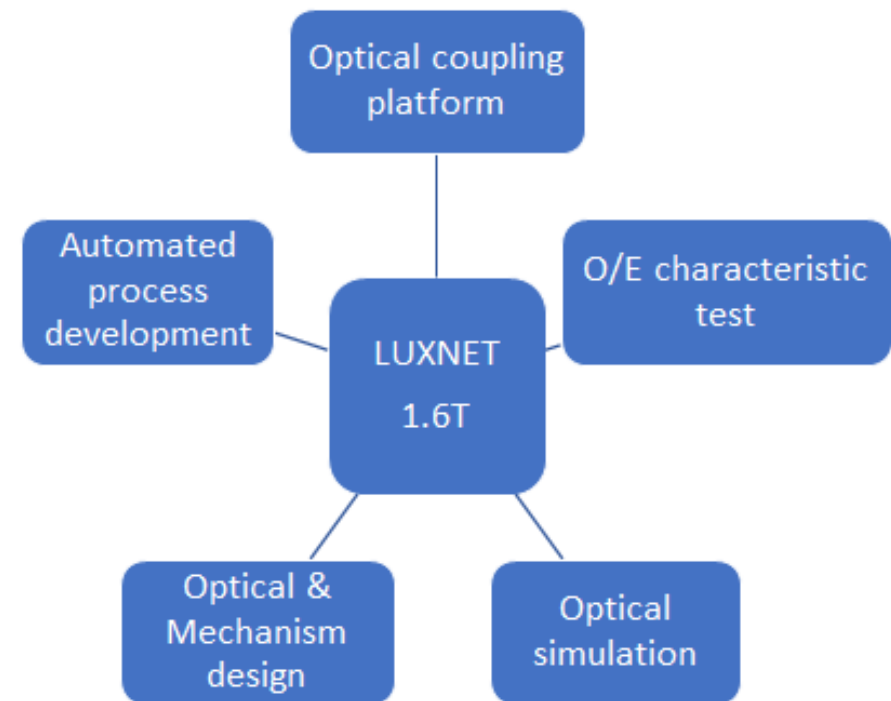
- Optical assembly
- Mechanical/Electrical integration
- Verification and testing
- O/E Characterization
- Data link test
- Reliability test



技術及製程能力- 光收發元件、矽光子及AI運用



- Opto-electronic chips: Laser, detector
- Provide precise epi-structure design
- Provide precise process design
- Capability of characteristic test
- Capability of reliability evaluation



- High precision coupling platform.
- O/E characteristic test capabilities.
- Optical simulation capabilities.
- Optical & Mechanism design capabilities.
- Automated process development capabilities.

技術及製程能力 - 無塵室



cleaning room:

二廠: 2025/H2

4F

Transceiver
Line (CM)



1000m²
(2025.Q1)

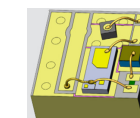
3F

1400m²



2F

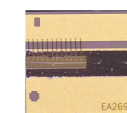
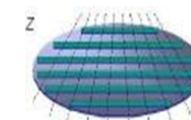
TO/OSA,
Optical Engine,
ELS, CoC



1400m²

1F

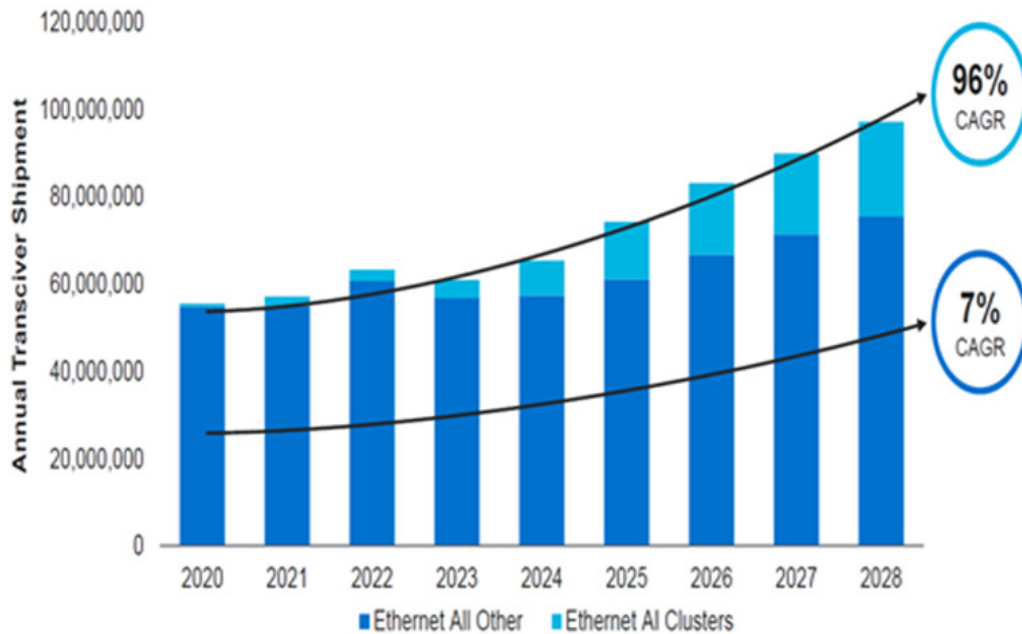
Laser Chip Line



1200m²

市場趨勢及未來展望 – AI & Datacenter

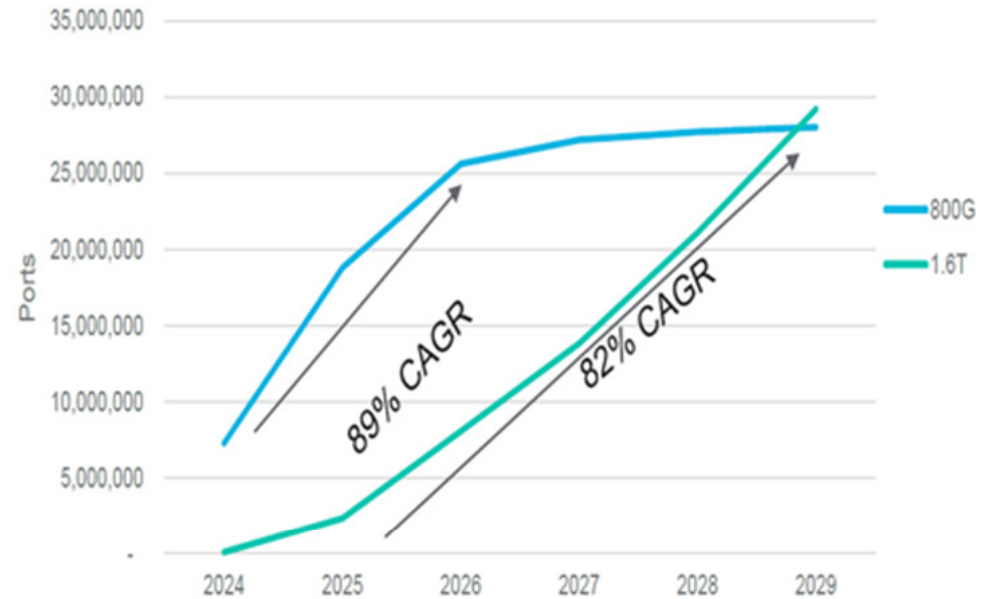
AI clusters growing faster than non-AI clusters



Source: LightCounting Mega Datacenter report, July 2023

Source: LightCounting

800G & 1.6T market trend



Courtesy of Lightcounting

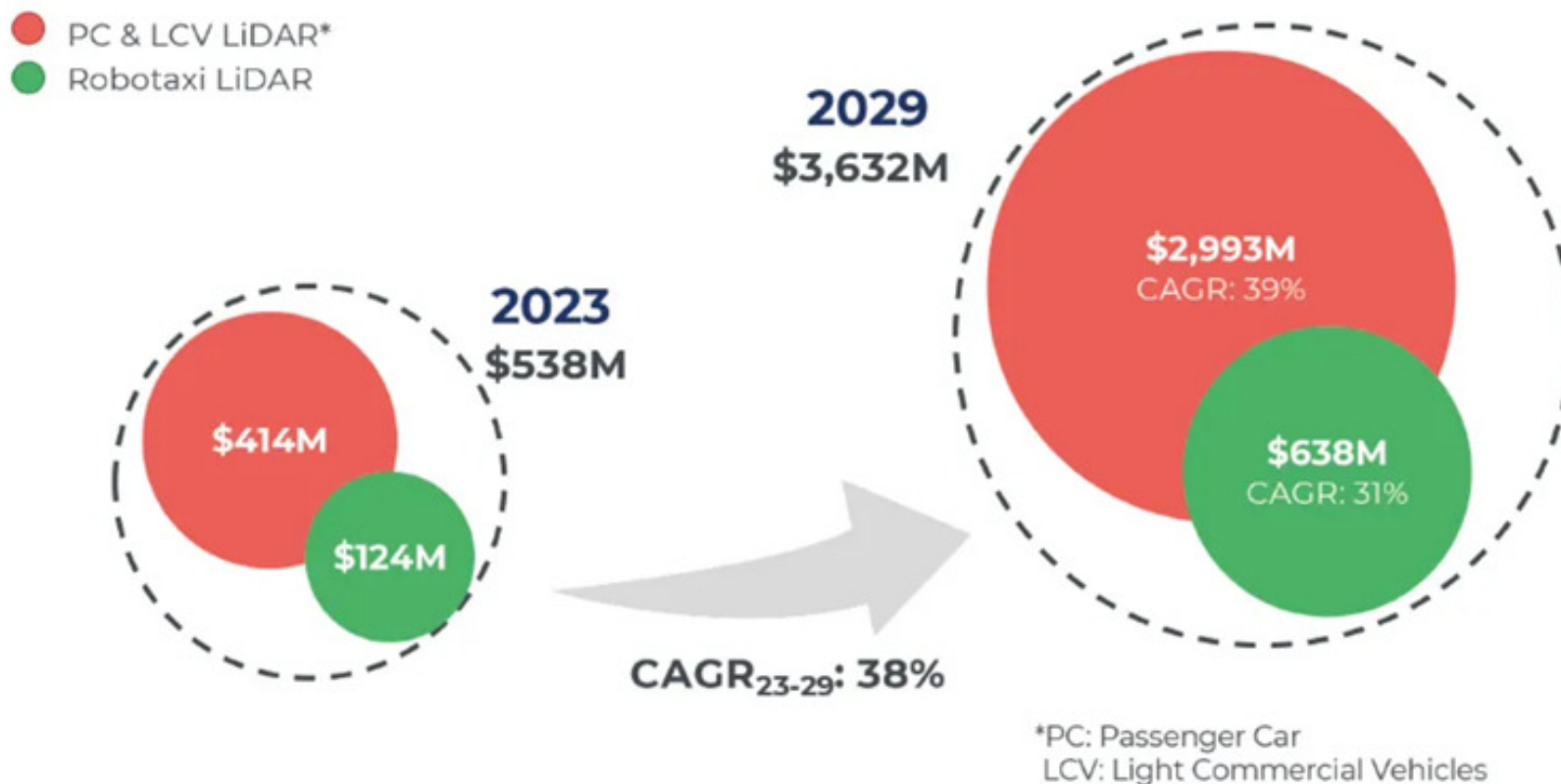
Source: LightCounting

- AI server 之間的傳輸也同等資料中心傳輸
- 整體來看 AI + Datacenter 的需求是向上提升，但AI的年複合成長是更驚人的96%
- 800G & 1.6T 於2024年同時在市場上面，現在800G還在向上趨勢中，1.6T預計2025下半年會有爆發性的成長
- 不論模塊代工 & 芯片代工，AI & Datacenter 都是我們主力產品

市場趨勢及未來展望 – LiDAR

2023-2029 overview of passenger car, light commercial vehicles and robotaxi markets

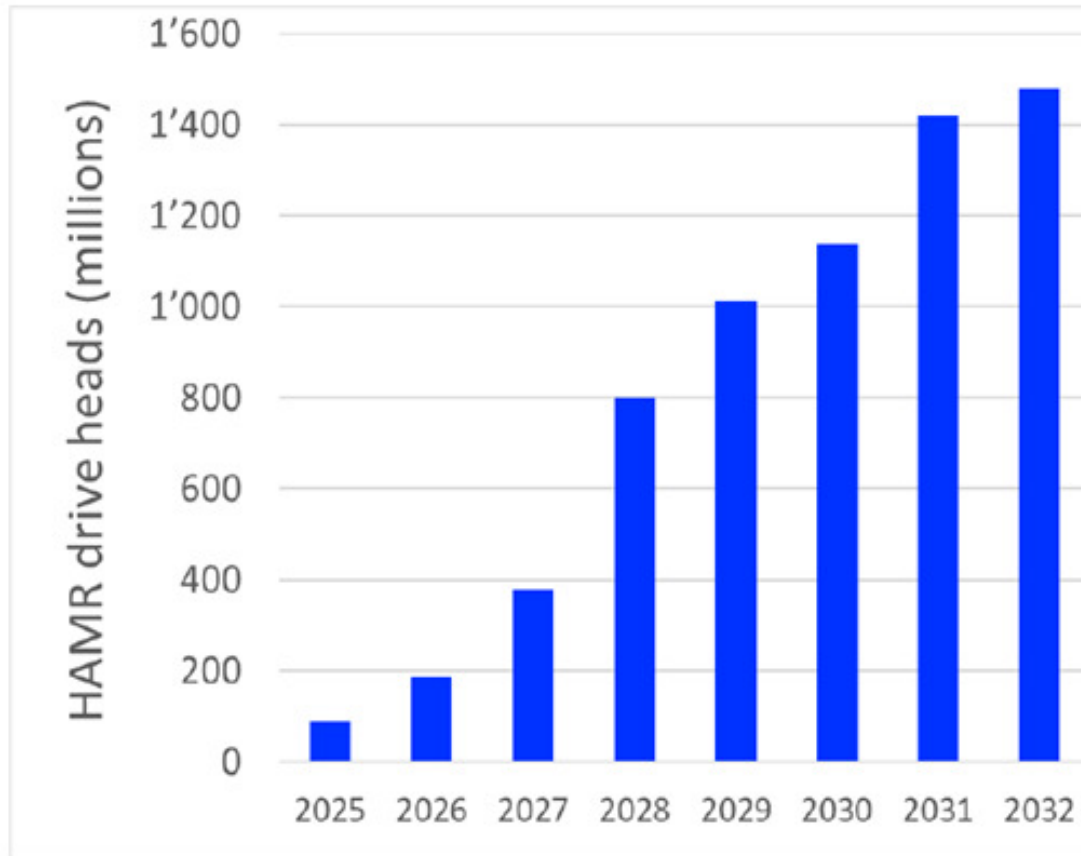
(Source: LiDAR for Automotive 2024, Yole Intelligence, June 2024)



Source: [Yole](#)

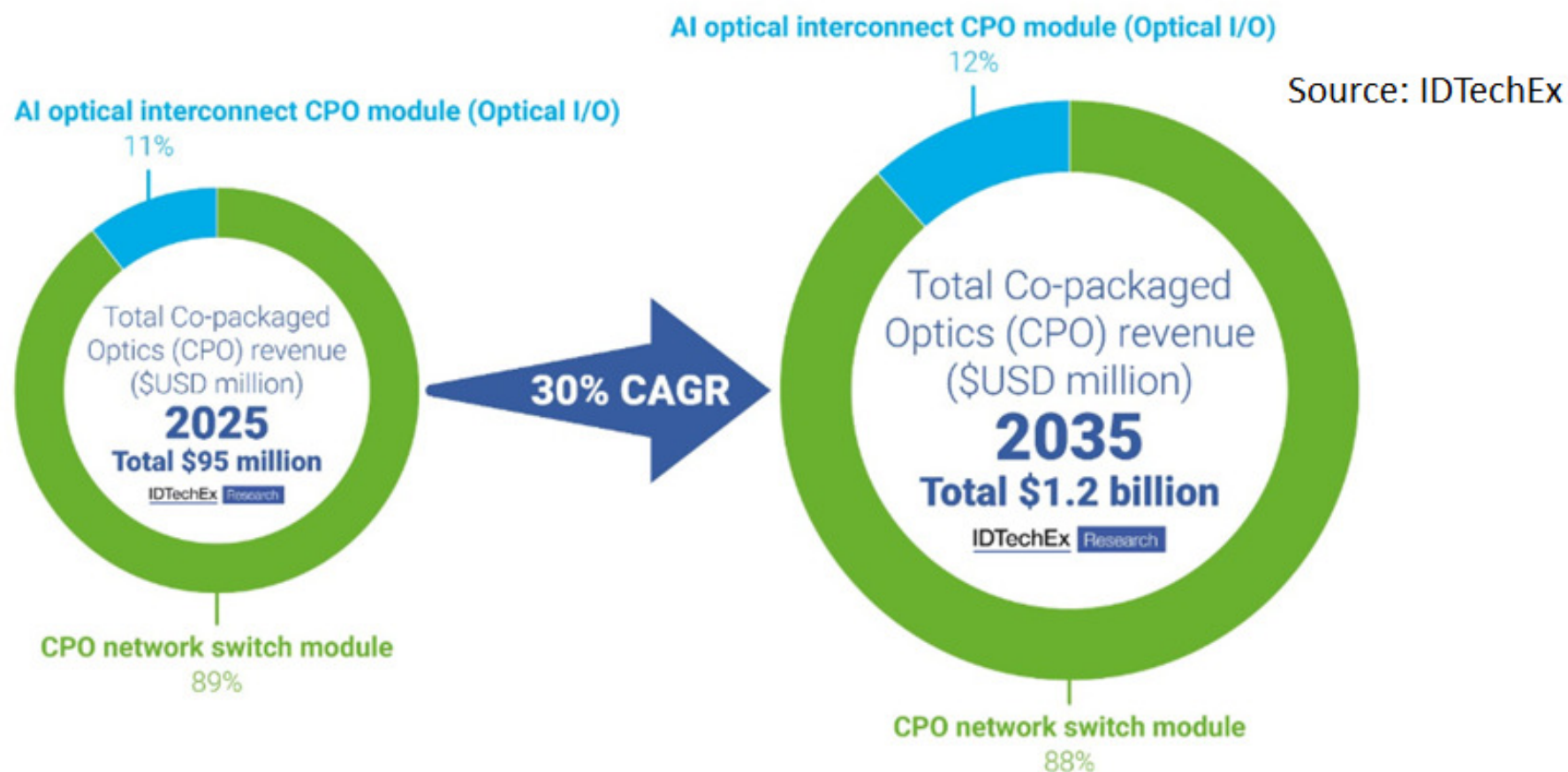
- LiDAR 主要用在 PC/LCV 及 [Robotaxi](#) 上
- 2023年，LiDAR市場達到5.4億美元，未來5五年內將達到35億美元
- 目前有跟客戶合作開發 LiDAR 的光學封裝模組，用在自駕車上

市場趨勢及未來展望 – HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording)



- AI server & Datacenter 除了資料傳輸，資料儲存也是占比非常大的一塊，能夠有效率的增加儲存密度、減少能耗、減少成本，HAMR是很重要的技術
- HAMR中會用到的光學模組是目前跟客戶開發中的重點項目
- 市場規模預計到2032年達到120million HD /年

市場趨勢及未來展望 – CPO



- 目前主流的通訊基礎設施使用 400G、800G 的可插拔式光學元件，預期進入 3.2 Tb/s 或更高傳輸速度時，會在散熱需求與功耗問題上遭遇挑戰，屆時 CPO 將結合矽光子技術，實現低功耗、高傳輸速度、傳輸距離更遠的優勢，滿足 AI 等相關應用對於高速運算的需求
- 根據 Yole 的預估，CPO 目前仍處於前期的測試階段，預計在 2~3 年後才能達成全面量產

技術聚焦

LiDAR



AI & Datacenter



HAMR



CPO

Q & A

THANK YOU

投資人關係窗口：王雅瑜

電話:886-3-4525188 分機2001

E-Mail : Kelly.Wang@luxnetcorp.com.tw